

(12) 特許協力条約に基づいて公開された国際出願

(19) 世界知的所有権機関
国際事務局

(43) 国際公開日
2024年6月20日(20.06.2024)



(10) 国際公開番号

WO 2024/127993 A1

(51) 国際特許分類:
H01L 21/66 (2006.01) G01R 31/319 (2006.01)
G01R 31/28 (2006.01)

(21) 国際出願番号: PCT/JP2023/042718

(22) 国際出願日: 2023年11月29日(29.11.2023)

(25) 国際出願の言語: 日本語

(26) 国際公開の言語: 日本語

(30) 優先権データ:
特願 2022-198898 2022年12月13日(13.12.2022) JP

(71) 出願人: 東京エレクトロン株式会社(TOKYO ELECTRON LIMITED) [JP/JP]; 〒1076325 東京都港区赤坂五丁目3番1号 Tokyo (JP).

(72) 発明者: 守谷 英純 (MORIYA, Hidesumi); 〒4078511 山梨県韮崎市藤井町北下条2381-1 東京エレクトロンテクノロジーソリューションズ株式会社内 Yamanashi (JP). 林 博昭 (HAYASHI, Hiroaki); 〒4078511 山梨県韮崎市藤井町北下条2381-1 東京

エレクトロン テクノロジーソリューションズ株式会社内 Yamanashi (JP).

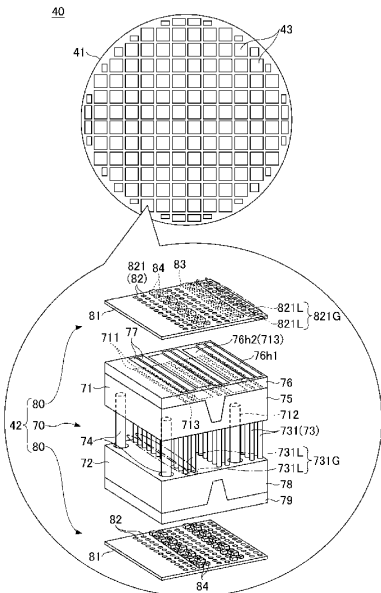
(74) 代理人: 伊東 忠重, 外(ITO, Tadashige et al.); 〒1000005 東京都千代田区丸の内二丁目1番1号 丸の内 M Y P L A Z A (明治安田生命ビル) 16階 Tokyo (JP).

(81) 指定国(表示のない限り、全ての種類の国内保護が可能): AE, AG, AL, AM, AO, AT, AU, AZ, BA, BB, BG, BH, BN, BR, BW, BY, BZ, CA, CH, CL, CN, CO, CR, CU, CV, CZ, DE, DJ, DK, DM, DO, DZ, EC, EE, EG, ES, FI, GB, GD, GE, GH, GM, GT, HN, HR, HU, ID, IL, IN, IQ, IR, IS, IT, JM, JO, KE, KG, KH, KN, KP, KR, KW, KZ, LA, LC, LK, LR, LS, LU, LY, MA, MD, MG, MK, MN, MU, MW, MX, MY, MZ, NA, NG, NI, NO, NZ, OM, PA, PE, PG, PH, PL, PT, QA, RO, RS, RU, RW, SA, SC, SD, SE, SG, SK, SL, ST, SV, SY, TH, TJ, TM, TN, TR, TT, TZ, UA, UG, US, UZ, VC, VN, WS, ZA, ZM, ZW.

(54) Title: CONNECTION ASSEMBLY AND INSPECTION DEVICE

(54) 発明の名称: 接続組立体、および検査装置

[図3]



(57) Abstract: This connection assembly comprises an intermediate connection member and a connecting substrate which is layered on the intermediate connection member. The intermediate connection member includes: a plurality of connection pins that electrically connect a plurality of tester-side terminals and a plurality of probe-card terminals respectively; a first frame portion that holds one end of the plurality of connection pins; a second frame portion that holds the other end of the plurality of connection pins; and an accommodating space provided in at least one of the first frame portion and the second frame portion. The connecting substrate includes: a conduction portion that is layered on the first frame portion and/or the second frame portion having the accommodating space, the conduction portion being electrically connected to the plurality of connection pins; and an electronic component that is electrically connected to the conduction portion and is disposed in the accommodating space.

[続葉有]

WO 2024/127993 A1

(84) 指定国(表示のない限り、全ての種類の広域保護が可能): ARIPO (BW, CV, GH, GM, KE, LR, LS, MW, MZ, NA, RW, SC, SD, SL, ST, SZ, TZ, UG, ZM, ZW), ユーラシア (AM, AZ, BY, KG, KZ, RU, TJ, TM), ヨーロッパ (AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LT, LU, LV, MC, ME, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR), OAPI (BF, BJ, CF, CG, CI, CM, GA, GN, GQ, GW, KM, ML, MR, NE, SN, TD, TG).

添付公開書類:

一 国際調査報告 (条約第21条(3))

(57) 要約: 接続組立体は、中間接続部材、および中間接続部材に積層される接続用基板を備える。中間接続部材は、複数のテスト側端子および複数のプローブカード側端子の間をそれぞれ電氣的に接続する複数の接続ピンと、複数の接続ピンの一端を保持する第1フレーム部と、複数の接続ピンの他端を保持する第2フレーム部と、第1フレーム部および第2フレーム部のうち少なくとも一方に設けられる収容空間と、を含む。接続用基板は、収容空間を有する第1フレーム部および/または第2フレーム部に積層され、かつ複数の接続ピンに電氣的に接続される導通部と、導通部に電氣的に接続され、収容空間に配置される電子部品と、を含む。